

報道関係各位

ダッソー・システムズ、パッケージ製品業界向け 新インダストリー・ソリューション・エクスペリエンス 「パーフェクト・パッケージ」を発売

3D エクスペリエンス・プラットフォームにより パッケージのデザイン工程をサプライチェーンに統合

3D エクスペリエンス企業であり、3D 設計、3D デジタル・モックアップ、そしてプロダクト・ライフサイクル・マネジメント (PLM) ソリューションにおける世界的リーダーであるダッソー・システムズ (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) は、パッケージ製品 (CPG) 業界向けの新インダストリー・ソリューション・エクスペリエンス「パーフェクト・パッケージ」を発表しました。本日より日本市場向けに展開します。ダッソー・システムズの 3D エクスペリエンス・プラットフォームを基盤とする「パーフェクト・パッケージ」は、パッケージのデザインプロセスをサプライチェーン全体に統合し、魅力的なパッケージデザインの実現と、製品のより迅速な市場投入の両立を可能にします。

これまでパッケージ開発の現場では、工程を進めるなかで幾度となく手戻りが発生し、結果的に最適とは言えないデザインが出来上がるといった状況が発生していました。「パーフェクト・パッケージ」インダストリー・ソリューション・エクスペリエンスは、パッケージデザインの工程全体を社内外で統合して連携を図ることで、かつてないスピードで画期的なパッケージデザインを実現します。本エクスペリエンスは、ブランドメーカー、デザイン会社、パッケージ・サプライヤー、アートワーク・スタジオの協業を容易にし、革新的なデザイン案の作成、ビジュアル化、検証をバーチャル環境で行い、関係者間のやり取りや意思決定を迅速化します。

「パーフェクト・パッケージ」は、革新的なパッケージ製品の開発を推進するとともに、パッケージのデザインサイクルの短縮、材料費の抑制を実現し、さらにはアートワークの作成と著作権の統合管理を強化することで、パッケージ関連のリコールのリスクを実質的に低減します。また、「パーフェクト・パッケージ」の活用により、パッケージデザインの再利用もしやすくなります。製品プロジェクトごとに新しいパッケージをデザインし直すことなく、既存デザインに変更を加えて別の製品に活用することで、時間の節約とパッケージの継続的な有効利用を促し、パッケージ製品メーカーは理想的なコンシューマー・エクスペリエンスの実現を通じて、最終消費者にこれまで以上に価値を提供できるようになります。

ダッソー・システムズのインダストリーおよびマーケティング担当、エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるモニカ・メンギニ (Monica Menghini) は次のように述べています。「消費財の市場では、スピード感が重視されます。そのなかで成功を収める企業、失敗する企業、そして、社会にインパクトを与える企業が存在します。製品の中身とそのプレゼンテーションであるパッケージデザインをぴったりと一致させることで、社会的にインパクトを与えることができます。パッケージはブランド資産における大切な要素であり、元来、製品の最初の、かつ最も重要な広告です。このことから当社は『パーフェクト・パッケージ』をつくる上での着想を得ました。素晴らしいコンシューマー・エクスペリエンスは、単に優れたデザイ

ンツールを使うだけでは実現できません。企業は、今日求められているデザイン・エクスペリエンスを、
当社の3Dエクスペリエンス・プラットフォームを通じて実現することができます。」

「パーフェクト・パッケージ」および「パーフェクト・シェルフ」をはじめとする一連のダッソー・システムズの
パッケージ製品・小売業向けインダストリー・ソリューション・エクスペリエンスの詳細はこちらをご覧ください：
<http://www.3ds.com/solutions/consumer-packaged-goods-retail/overview/>.

(以上)

ダッソー・システムズについて

ダッソー・システムズは、3D エクスペリエンス企業として、企業や個人にバーチャル・ユニバースを提供することで、持続可能なイノベーションを提唱します。世界をリードする同社のソリューション群は製品設計、生産、保守に変革をもたらしています。ダッソー・システムズのコラボレーティブ・ソリューションはソーシャル・イノベーションを促進し、現実世界をよりよいものとするため、バーチャル世界の可能性を押し広げます。ダッソー・システムズ・グループは 140 カ国以上、あらゆる規模、業種の 15 万社以上のお客様に価値を提供しています。より詳細な情報は、www.3ds.com（英語）、www.3ds.com/jp（日本語）をご参照ください。

CATIA、SOLIDWORKS、SIMULIA、DELMIA、ENOVIA、GEOVIA、EXALEAD、NETVIBES、3DSWYM および 3D VIA はアメリカ合衆国、またはその他の国における、ダッソー・システムズまたはその子会社の登録商標です。